

# 上海骄成超声波技术股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站披露了公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，在提升经营质量、推动创新发展、保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了阶段性成果。现将 2026 年上半年的主要工作成果报告如下：

### 一、 聚焦主营业务发展，持续提升核心竞争力

2026 年上半年，公司以超声波技术为核心，扎实推进“功率超声+检测超声”技术发展规划，重点围绕新能源、半导体、医疗等领域开展核心技术创新和工艺优化，为客户提供专业、高质量的超声波应用及智能装备解决方案。

#### （一）专注主营业务，加快市场拓展和产品布局的实施情况

报告期内，公司紧密围绕战略发展规划和年度目标，通过优化产品结构、加强供应链管理、工艺技术创新等方式，切实推进各业务板块提质增效工作，持续提升经营管理效率。2026 年上半年，公司经营规模持续扩大，实现营业收入 44,622.28 万元，同比增长 38.24%，归属于上市公司股东的净利润 10,294.50 万元，同比增长 77.38%。本期公司收入与利润均实现快速增长，经营效率及盈利能力进一步增强。

受益于新能源电池特别是储能电池市场需求持续增长，公司新能源电池领域业务实现较快发展。公司深耕新能源电池行业，协助重点客户开拓超声技术应用新场景，同时围绕下游技术迭代与产线痛点，推进超声产品升级迭代。报告期内，公司持续开展控制系统、声学结构等方面的技术迭代升级，积极拓展快充电池、大储能电池、固态电池等新型电池应用场景，深度参与下游技术演进，为新型电

池工艺设备研发夯实基础。公司双峰焊机、伺服高速焊机等新机型落地规模持续扩大，焊接质量监控系统、超声波除尘设备等有效助力客户解决产线焊接及检测痛点。公司通过持续迭代产品、优化核心工艺、加大新产品推广等措施，持续提升市场份额，巩固在新能源电池领域的领先优势。

在线束连接器领域，公司积极把握下游市场对高电压、大电流等技术升级带来的新需求，持续拓展线束连接器超声波设备种类覆盖范围，构建了覆盖超声波线线焊接、线束端子焊接的完整产品矩阵。公司持续加大线束连接器超声波焊接设备的推广，快速抢占新能源汽车高低压线束、充电桩、储能场景等应用市场，业务开拓成果显著。报告期内，公司持续加强与海内外头部线束、连接器客户的协同合作，定制化开发适配场景的解决方案，推动更多产品通过国际权威认证，巩固行业优势地位。

在功率半导体领域，公司凭借提供超声波端子焊接机、超声波 Pin 针焊接机、超声波键合机、超声波扫描显微镜等整套专业解决方案与优质服务，与上汽英飞凌、中车时代、振华科技、芯联集成等知名企业保持良好合作，并持续扩大市场份额。报告期内，公司超声波键合机获得某半导体头部客户批量订单，充分体现了公司技术实力、产品可靠性和服务能力已获得下游客户的充分验证与持续信赖。在半导体先进封装领域，公司聚焦先进封装晶圆级超声波扫描显微镜以及超声波固晶机等产品的升级迭代。报告期内，可应用于半导体晶圆、2.5D/3D 封装、面板级封装等产品的先进超声波扫描显微镜成功获得国内头部半导体存储厂商小批量复购订单，标志着公司该款产品的性能、可靠性等获得头部存储客户的持续肯定和认可，是公司半导体先进封装领域业务的重要商业化突破。同时，公司持续推进先进超声波扫描显微镜在 MEMS、Micro-LED 等领域的客户导入及产品验证，各项验证工作开展良好；新一代超声波固晶机验证亦取得顺利进展。公司将结合下游市场需求与客户应用反馈等持续迭代优化产品，充分把握半导体设备国产替代机遇，为半导体先进封装业务后续规模放量筑牢基础。

## （二）坚持创新发展，不断提升公司核心竞争力的实施情况

公司密切关注超声波技术及应用领域的新技术、新产业、新业态及发展趋势，结合客户需求和行业发展趋势持续进行技术更新，不断提升核心竞争力，力争实现高质量可持续发展。报告期内，公司研发投入 8,594.14 万元，同比提升 13.71%。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已取得有效授权专利 374 项，软件著作权 70 项。

公司拥有一批在超声波技术领域具备丰富的研发工作经验和创新能力专业人才，并不断引进国内外高端人才，组建了一支极具竞争力的研发团队，经过行业深耕多年，核心人员对行业研发趋势有深刻的研究和把控。截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 349 人，占公司总人数的比例为 32.96%。公司通过持续加大研发投入以及专业人才体系构建，促进核心技术快速落地转化，向半导体行业多家知名客户完成交付，并获得客户充分认可，充分印证了公司的技术实力与创新价值。

报告期内，公司通过持续的专业培训进一步提升现有员工的技术水平，进一步优化研发激励机制，积极加强对公司知识产权的保护。2026 年上半年，公司新增获得授权专利 23 项，软件著作权 8 项。同时公司持续针对半导体先进封装领域超声技术进行重点投入和攻克，为业务长期可持续发展提供技术保障。本期公司主要产品的研发进展如下：

| 产品类别           |                    | 2026 年度主要新产品研发计划                                                                                                              | 主要产品研发进展                                                                                                     |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功率<br>超声<br>设备 | 新能源电<br>池超声波<br>设备 | 完成超声波双峰焊机、多向焊机等新型焊机的量产开发；<br>推进伺服超声波焊机、焊接熔深检测系统、超声波分散系统、超声波除尘系统、振动监控系统、焊接面积无损检测系统等产品验证和量产开发工作,以及对部分焊接设备机型升级的量产研发,解决客户和行业痛点问题。 | 伺服超声波焊机、超声波双峰焊机、超声波除尘系统已通过头部电池厂商验证，并获得订单；<br>完成焊接熔深检测系统、振动监控系统、焊接面积无损检测系统等等的量产开发，实现了焊接环节的闭环质量控制，解决客户和行业痛点问题。 |
|                | 线束连接<br>器超声波<br>设备 | 推进低压线束领域高速焊机以及多种焊接机型的开发；<br>推进底模振动监控系统的量产开发工作；<br>推进超大功率超声系统的研发和验证工作。                                                         | 低压线束领域部分型号已通过下游知名客户验证，并获得订单；<br>底模振动监控系统已进入头部电池厂商等客户的供应链，并获得订单<br>推进超大功率超声系统的研发和验证工作，相关验证进展顺利。               |
|                | 半 导 体 超<br>声 波 设 备 | 完成超声波双头键合机的量产研发工作；<br>推进端子焊机和 Pin 针焊机的迭代升级工作；<br>推进超声波固晶机升级及验证工作；<br>推进多功能先进贴装系统的研发工作。                                        | 完成超声波双头键合机的量产研发，并获得订单；<br>持续推进端子焊机和 Pin 针焊机的迭代升级，持续提升设备稳定性、效率以及配件使用寿命；<br>顺利推出新一代超声波固晶机                      |

|                |            |                                                                   |                                                                                             |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            |                                                                   | SDB-300，并推进相关验证工作；有序推进多功能先进贴装系统的研发工作。                                                       |
| 检测<br>超声<br>设备 | 超声波扫描显微镜   | 加强用于新能源电池、液冷板、功率模块、电子元器件、陶瓷基板等各类工件的超声波扫描显微镜研发工作；对全自动超声波扫描显微镜升级研发。 | 用于新能源电池、液冷板、功率模块、电子元器件、陶瓷基板等的超声波扫描显微镜研发进展顺利，并获得订单；完成全自动超声波扫描显微镜机型开发，部分型号已通过下游知名客户验证，并获得订单。  |
|                | 先进超声波扫描显微镜 | 推进用于晶圆级封装、2.5D/3D 封装及面板级封装等工艺环节的先进超声波扫描显微镜的迭代及验证工作。               | 完成 Wafer400-F2 系列产品开发，可兼容支持 Wafer to Wafer（W2W）和 Die to Wafer（D2W）两种主流先进封装工艺路线，并顺利推进相关验证工作。 |
| 配件             | 各类配件       | 加强多种类发生器、换能器、控制箱、声学结构等配件的开发；推进焊头、劈刀等声学配件的开发。                      | 持续推进多种发生器、换能器、控制箱、声学结构以及焊头、劈刀等配件的开发，相关进展顺利。                                                 |

(三)优化财务管理，提高经营效率的实施情况

公司通过工艺优化、强化成本控制、加速存货周转、提高资金使用效率等措施，持续优化财务管理，不断提高经营效率。报告期内，公司产品综合毛利率达 63.94%，保持在较高水平。在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，公司充分利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，确保持续收益的稳定性和可持续性，实现资金效益最大化，2026 年上半年度实现理财收益 788.88 万元。

(四)有序推进募投项目建设，积极推进扩产和研发布局

报告期内，公司积极推进首次公开发行股票募集资金投资项目“智能超声波设备制造基地建设项目”建设，该项目在无锡构建智能制造生产基地，购进先进生产设备用于生产超声波设备及配件，扩大公司业务规模和生产能力。2025 年以来，随着下游新能源等领域市场需求增长以及公司业务持续拓展，公司新签订单规模显著提升，无锡生产基地产能利用率已处于较高水平，固定资产投资需求增加。截至 2026 年 6 月 30 日，该项目募集资金使用比例已达 57.01%。

面对下游半导体、新能源等产业快速发展及国产替代带来的市场机遇，为进一步提升公司核心技术研发实力与产能供给水平，构建覆盖功率超声、检测超声的全面技术平台，夯实中长期经营发展基础，公司于报告期内披露了 2026 年度

向特定对象发行 A 股股票预案，拟募集资金不超过 13.44 亿元（含本数）投向半导体先进超声设备研发及产业化项目、高性能功率超声设备研发升级及产业化项目、检测超声技术平台建设项目以及补充流动资金。通过本次募投项目的实施，公司将有效突破产能瓶颈，快速响应下游市场需求，进一步提升在半导体、新能源等领域的市场份额，并借助超声技术平台化优势加速切入航空航天、医疗等新领域，实现新的业务增长点。

## **二、 共享发展成果，重视股东回报**

公司于 2026 年 6 月完成了 2025 年年度权益分派实施，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，合计派发现金红利 2,256.49 万元（含税）。

公司高度重视对投资者的合理投资回报，按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，自 2025 年开始连续实施中期分红，积极回报投资者。2026 年 3 月 30 日和 2026 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十三次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在满足相关条件前提下制定和实施 2026 年中期分红方案。2026 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2026 年 8 月 28 日，公司总股本 115,733,360 股，扣除回购专用证券账户中股份数量 2,908,936 股后的股份总数为 112,824,424 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,256.49 万元（含税），占 2026 年上半年归母净利润的 21.92%。

公司将根据公司《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》，统筹经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续落实积极稳健的分红政策，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，制定合理的利润分配方案，持续优化股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感。

## **三、 强化管理层与股东的利益共担共享约束，发挥“关键少数”积极作用**

报告期内，为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，根据《中

华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定并披露了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，遵循“责权利对等、业绩联动、市场化与可持续、激励与约束并重”的原则，建立了薪酬止付追索等约束机制，强化高级管理人员、董事、股东之间的利益共担共享机制，为有效调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司治理水平和经营效益，促进公司健康、持续、稳定发展提供了制度保障。

#### **四、提升公司规范运作水平，推动公司高质量发展**

公司积极开展定期报告和重大事项的窗口期管理、内幕信息知情人管理等工作，并结合监管警示案例的宣导，及时传递监管动态，保障董事、高管合规履职，推动公司持续规范运作。公司独立董事通过参加会议、现场走访以及听取管理层汇报等方式及时掌握公司运行动态，积极履行职责。

报告期内，公司组织董事、高管参加了监管机构举办的“上市公司财务规范运作重点关注事项专题培训”等专项培训，及时向大股东、董事、高管转发上海证券交易所下发的《科创板监管直通车》等相关资料，促使其能够实时掌握监管政策动态，不断提升自律意识，增强其合规履职能力，推动公司持续规范运作。

#### **五、加强投资者沟通，树立资本市场良好形象**

报告期内，公司严格遵守法律法规和监管机构规定，切实执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务。公司高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、上交所互动平台、投资者关系专线、接待投资者现场调研及电子邮件等渠道加强与投资者的沟通，及时回复投资者关心的问题，加强投资者对公司经营情况和业务进展的了解，建立了良好的投资者互动机制。

报告期内，公司在定期报告披露后，参加了上海证券交易所主办的“十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体设备行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流，并发布2025年年度报告可视化图文对定期报告进行解读，助力投资者了解公司业务和行业发展情况。公司通过多渠道积极与投资者保持密切沟通，进一步提升沟通效率与沟通质量，打造高效透明的沟通平台。

#### **六、其他事宜**

报告期内，公司坚持以主营业务为核心，持续优化运营管理，在提升经营质量、推动创新发展、保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了阶段性成果。下半年，公司将继续聚焦超声波技术研发和应用，持续提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司良好的市场形象。

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2026年8月29日